JP-250AB

PCB 及电子零件保密灌注胶

UL File No. E354546

特　　点

- 符合 UL 认证 UL94 V-0 及相对耐温指数 RTI 130°C。
- 常温下硬化或加温加速硬化，硬化后外观光亮平整。
- 低黏度，自流平性佳，容易操作混合与灌注及优异的电气性能。

物　　性

		主剂 (A剂)	硬化剂 (B剂)
颜　　色：		黑色	深褐色
黏　　度：	@25°C	5,000 - 10,000 cps	120 - 280 cps
比　　重：	@25°C	1.4 - 1.5	1.03 - 1.13
重量混合比：		100：25	
混合后黏度：	@25°C	2,000 - 3,000 cps	
可操作时间：	@25°C	30 分钟	
硬化条件：		@25°C x 16-24 小时	
		@60°C x 2-4 小时	
		(硬化后放置 7 天到达完整物性)	
硬　　度：		Shore D 80	
耐　燃　性：	UL94	V-0	
压缩强度：		9.8 kg/mm^2	
抗张强度：		7.5 kg/mm^2	
绝缘强度：		20 kV/mm (508 volts/mil)	
体积电阻：		1.0 x 10^{15} ohm-cm	
热膨胀系数：		20 x 10^{-6} in/in/°C	
绝缘常数：	@60Hz	4.1	
消散因素：	@60Hz	1.9	
保存期限：	@25°C	1 年 (未开封)	

※主剂于使用前需预先搅拌均匀。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 · FAX：021-58356976